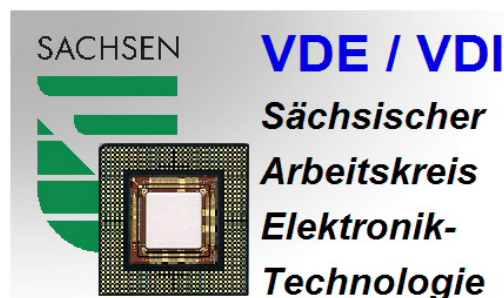


Obmann: Prof. Dr.-Ing. Reinhard Bauer
Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden
e-mail: reinhard.bauer@htw-dresden.de

Koordinierung: PD, Dr.-Ing. habil. Martin Oppermann, TU Dresden
e-mail: martin.oppermann@tu-dresden.de

<https://www.avt.et.tu-dresden.de/saet/arbeitskreis/>



79. Treffen des Sächsischen Arbeitskreises Elektronik-Technologie



Fraunhofer-Institut für Werkzeugmaschinen und Umformtechnik IWU

Thema: **Technologien für 3D-gedruckte Sensorik - Stand der Technik und Potentiale**

am **Mittwoch, 05. Oktober 2022**

Ort **Fraunhofer IWU
Nöthnitzer Straße 44
01187 Dresden**

Programm:

- 10:00 Uhr Begrüßung durch Reinhard Bauer (Obmann SAET) und Wolfgang Zorn (Fhg IWU)
- 10:10 Uhr **Strukturkonforme Integration elektrischer Funktionalitäten in Komponenten – Technologien und aktueller Stand**
Philipp Dobeleit, Fraunhofer IWU
- 10:30 Uhr **3D printed Electronics – new design thinking & prototyping**
Abraham Contreras Avila, Nano Dimension Inc.
- 10:50 Uhr **Kaffeepause**
- 11:10 Uhr **Erfahrungen im Siebdruck mit leitfähigen Pasten (Online-Beitrag)**
Martin Fiebrandt, Motherson Innovation Lights
- 11:30 Uhr **Anwendungspotentiale gedruckter flexibler und 3D-geformter Elektronik**
Wolfgang Mildner, MSW Tech
- 11:50 Uhr **Prozesse zur Fertigung von 3D Printed Electronics**
Johannes Hörber, Neotech AMT
- 12:10 Uhr **Mittagspause**
- 13:00 Uhr **Diskussionen zur Einsetzbarkeit von Biopolymeren in der Elektronik und Sensorik an ausgewählten Beispielen**
Daniel Firzlaff, HTW Dresden

- 13:20 Uhr **Kontaktierung und Entwicklungspotentialle gedruckter Systeme**
Jan Fröhlich, Universität Erlangen, FAPS
- 13:40 Uhr **Werkzeugintegrierte Sensor- und Aktorsysteme**
Dr. Wolfgang Zorn, Fhg IWU
- 14:00 Uhr **Kaffeepause**
- 14:30 Uhr **Führung durch das Institut (2...4 Gruppen)**
- 16:00 Uhr **Abschlussdiskussion und Ende der Veranstaltung**